

电子

科创板正式登场，集成电路成重中之重

科创板规则正式落地。2018年11月5日，习总书记宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。各大部门积极响应，科创板是资本市场的重大制度创新，经中国证监会批准后，正式向市场发布实施。上海证券交易所于3月1日正式发布实施科创板相关业务规则和配套指引，对红筹企业上市标准、股份减持制度、信息披露审核内容和要求以及督导职责边界做了新的更新和调整，但科创板50万资产门槛和2年证券交易经验门槛不变，T+1交易机制不变。上海市委书记李强也曾经强调，科创板要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域。

半导体—十年产业投资大机会。中国半导体市场规模占全球比重持续提高。中国半导体行业协会预计2018年全球半导体收入将达到4779.36亿美元，实现连续3年稳步增长。其中，中国为全球需求增长最快的地区。随着5G、消费电子、汽车电子等下游产业的进一步兴起，叠加全球半导体产业向大陆转移，中国将持续成为全球最大和贸易最活跃的半导体市场。我国集成电路市场增速全球第一，预计2018再增20%，达到993.1亿美元。中国集成电路产业持续扩大，在全球的占比持续提高，已成为全球主要消费市场。

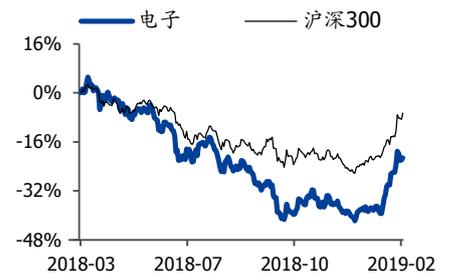
集成电路领域公司有望搭上科创板的“首班车”。科创板为电子领域企业尤其是集成电路带来了充分的机遇。科创板主要针对的企业来自五大行业领域，其中包括新一代信息技术，包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网以及技术服务领域，主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的企业。自2018年11月5日以来，上海证监局披露接受上市辅导的有十余家，具有登录科创板潜力，其中半导体领域的企业占比较大。

推荐重点配置半导体、5G、有业绩保障的消费电子。半导体：存储：兆易创新；模拟：韦尔股份、圣邦股份、富满电子；数字芯片 GPU：景嘉微；AP：北京君正、全志科技；IDM：闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电子；化合物半导体：三安光电；设备：北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技；材料：兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子；封测：长电科技、华天科技、通富微电；安防：海康威视、大华股份、千方科技；消费电子：立讯精密、欧菲科技、领益制造、东山精密、环旭电子、蓝思科技、信维通信；PCB：深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎科技、生益科技；5G相关：深南电路、沪电股份、硕贝德、麦捷科技；面板以及相关：京东方、劲拓股份、濮阳惠成；元器件：火炬电子、顺络电子、三环集团、法拉电子。

风险提示：下游需求增长不及预期、宏观环境边际恶化。

增持（维持）

行业走势



作者

分析师 郑震湘

执业证书编号：S0680518120002

邮箱：zhengzhenxiang@gszq.com

相关研究

- 1、《电子：华为5G折叠手机正式推出，关注结构性创新机会》2019-02-25
- 2、《电子：每周专题：估值修复到拐点成长，强烈推荐电子龙头》2019-02-24
- 3、《电子：歌韵巧共泉声——TWS耳机系列研究之一》2019-02-21



内容目录

一、科创板规则正式落地.....	3
1.1 上交所正式发布实施设立科创板业务规则和配套指引	3
1.2 半导体—十年产业投资大机会	5
1.3 哪些电子公司有望登上科创板的“首班车”？	8
二、投资组合推荐.....	17
三、电子本周行业动态.....	17
四、本周行情回顾.....	20
风险提示.....	21

图表目录

图表 1: 一张表看懂科创板与主板、中小板、创业板的区别	4
图表 2: 科创板推进进程.....	5
图表 3: 全球及中国集成电路销售额.....	6
图表 4: 存储器是全球半导体景气度的主要推手（百万美元）	6
图表 5: 全球及中国半导体销售额(单季度，亿美元).....	7
图表 6: 全球半导体市场增速.....	7
图表 7: 中国半导体市场增速.....	7
图表 8: 从我国产业市占率看产业迁移.....	8
图表 9: 有望首批登陆科创板的公司.....	9
图表 10: 澜起科技发展历程.....	9
图表 11: 澜起科技主要产品.....	10
图表 12: 公司主要产品.....	11
图表 13: 芯原半导体的业务模式.....	12
图表 14: 东芯半导体发展历程.....	12
图表 15: 公司主要产品.....	13
图表 16: 集创北方主要产品.....	13
图表 17: 华润微电子核心产业链.....	14
图表 18: 聚辰半导体主要产品.....	15
图表 19: 公司主要产品.....	15
图表 20: 上海微电子发展历程.....	16
图表 21: 公司主要产品.....	17
图表 22: 华为首款折叠屏手机.....	18
图表 24: 申万一级行业周涨跌幅	20
图表 25: 电子行业指数相对沪深 300 表现.....	21
图表 26: 细分行业周涨跌幅.....	21

一、科创板规则正式落地

1.1 上交所正式发布实施设立科创板业务规则和配套指引

上海证券交易所于3月1日正式发布实施科创板相关业务规则和配套指引，对红筹企业上市标准、股份减持制度、信息披露审核内容和要求以及督导职责边界做了新的更新和调整，但科创板50万资产门槛和2年证券交易经验门槛不变，T+1交易机制不变。**2018年11月20日**，上海市委书记李强在上交所主持召开座谈会时指出，科创板要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域。

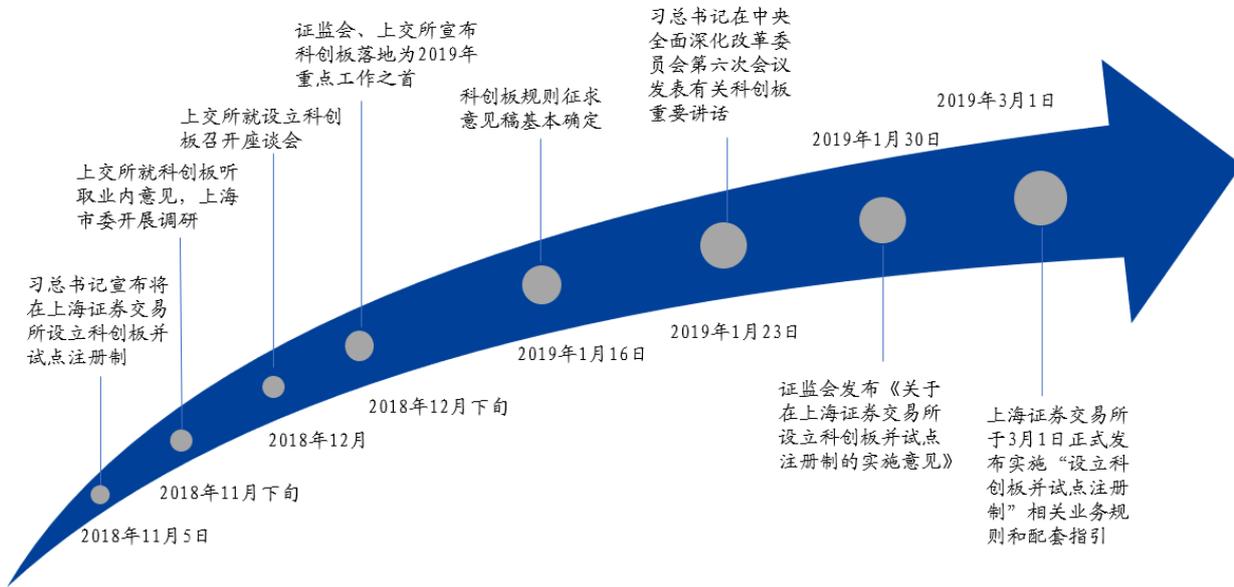
图表 1: 一张表看懂科创板与主板、中小板、创业板的区别

规定	主板及中小板	创业板	科创板
上市场所	主板(上交所、深交所)、 中小板(深交所)	深交所	上交所
市场类型	场内市场	场内市场	场内市场
存续时间	存续满三年	存续满三年	存续满三年
盈利要求	近三个会计年度净利润为正, 累计超过 3000 万元, 净利润以扣除非经常损失后较低者为计算依据	近两年连续盈利, 净利润累计不少于 1000 万元; 或近一年净利不少于 500 万元, 近两年营收增长率不低于 30%	预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元, 或预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。
现金盪要求	近三个会计年度现金流累计超过 5000 万元; 或三个会计年度应收超过 3 亿元	无	预计市值不低于人民币 20 亿元, 最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元, 且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元。
股本盪求	发行后股本总额不少于 5000 万元	发行后股本总额不低于人民币 3000 万元	发行后股本总额不低于人民币 3000 万元。
市值要求	无	无	预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元, 或预计市值不低于人民币 10 亿元, 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元; 预计市值不低于人民币 15 亿元, 最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元, 且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%; 预计市值不低于人民币 20 亿元, 最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元, 且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元; 预计市值不低于人民币 30 亿元, 且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元; 预计市值不低于人民币 40 亿元, 主要业务或产品需经国家有关部门批准, 市场空间大, 目前已取得阶段性成果。
主营业务要求	最近 3 年主营业务没有发生重大变化	发行人应当主业经营一种业务, 其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策及环境保护政策	发行人生产经营符合法律、法规的规定, 符合国家产业政策。重点支持五大行业。
上市审核	核准制	核准制	注册制
投资者门槛	一般投资者	原则上具有两年以上(含两年)股票交易经验的投资者	前 20 交易日日均股票资产 50 万, 两年交易经验。
股东人数要求	不少于 200 人	不少于 200 人	无
支持 VIE	否	否	是, 但市值要求高于一般企业。
涨跌幅限制	涨跌幅限制比例为 10%	涨跌幅限制比例为 10%	前 5 交易日不设涨跌幅, 之后 20% 涨跌幅限制。

资料来源: 搜狐科技、国盛证券研究所

2018年11月5日，习总书记宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。各大部门积极响应，科创板是资本市场的重大制度创新，经中国证监会批准后，正式向市场发布实施。

图表 2: 科创板推进进程



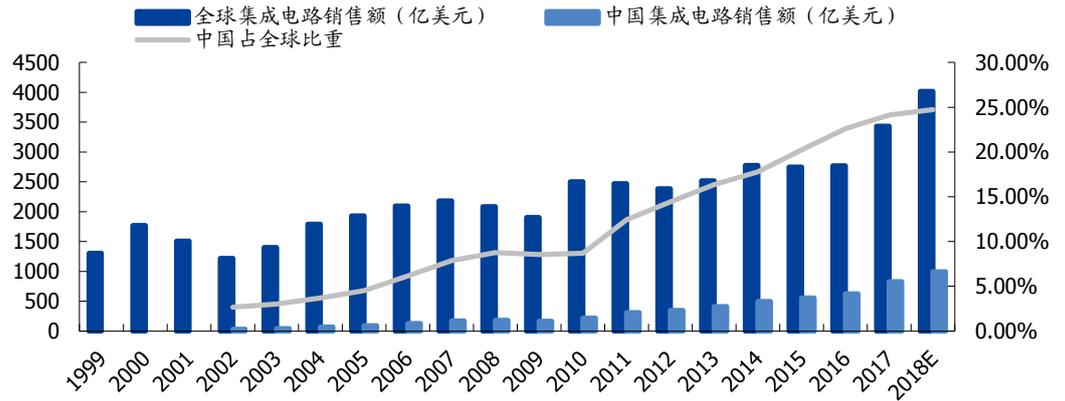
资料来源: 上交所、国盛证券研究所

1.2 半导体—十年产业投资大机会

中国半导体市场规模占全球比重持续提高。据中国半导体行业协会等统计，2017年受存储器涨价影响和物联网需求推动，全球半导体收入约4122.21亿美元，同比增长16%。预计2018年全球半导体收入将达到4779.36亿美元，实现连续3年稳步增长。其中，中国为全球需求增长最快的地区。2017年国内半导体销售额为1102.02亿美元，同比增长19.9%。随着5G、消费电子、汽车电子等下游产业的进一步兴起，叠加全球半导体产业向大陆转移，中国将持续成为全球最大和贸易最活跃的半导体市场。预计2018我国半导体销售额再增20%，达到1322亿美元。

我国集成电路市场增速全球第一。2016年我国集成电路销售额624.98亿美元，2017年为828.15亿美元，同比增长32%，是全球集成电路产业增速最快的区域。预计2018再增20%，达到993.1亿美元。统计2000年以来18年间集成电路产业销售规模年均增速，中国CAGR为20.6%，全球CAGR为4.8%。中国集成电路产业持续扩大，在全球的占比持续提高，已成为全球主要消费市场。

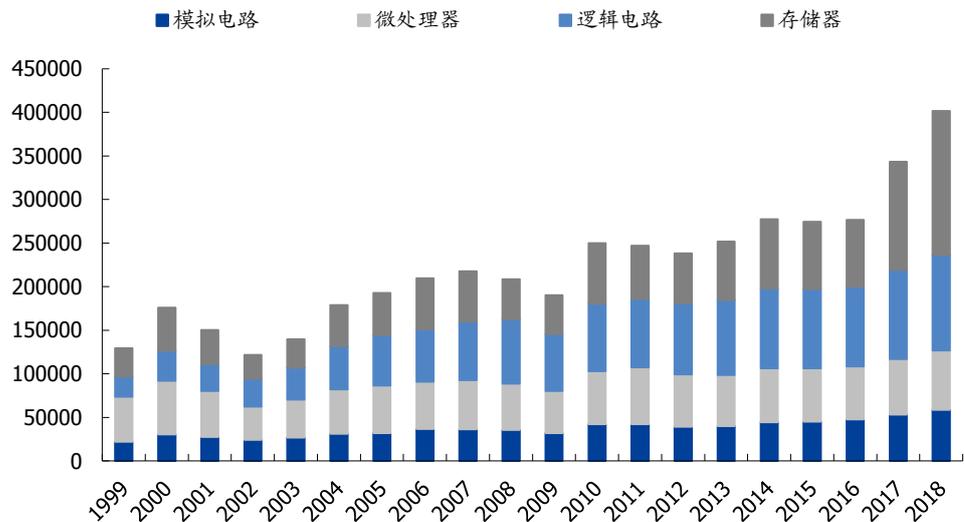
图表 3: 全球及中国集成电路销售额



资料来源: 中国半导体行业协会、全球半导体贸易统计组织、《2018-2024年中国集成电路行业市场深度分析及投资前景预测报告》、国盛证券研究所

从全球集成电路市场结构来看, 全球半导体贸易统计组织预计 2018 年全球集成电路市场规模达 4015.81 亿美元, 相较于本轮景气周期起点 2016 年增长了 1249 亿美元。而存储器 18 年市场规模达 1651.10 亿美元, 相较 2016 年增长了 883 亿美元, 占增量比重达 71%, 是本轮景气周期的主要推手。

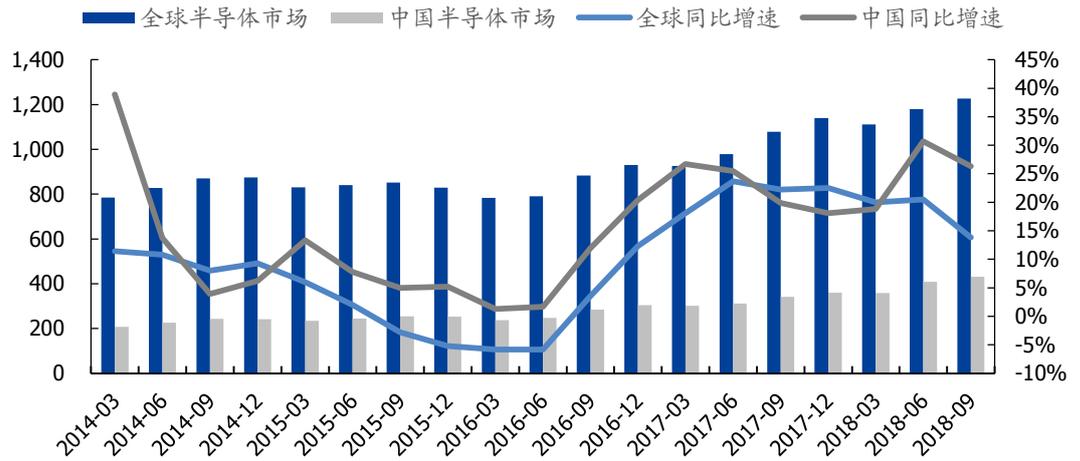
图表 4: 存储器是全球半导体景气度的主要推手 (百万美元)



资料来源: WSTS、国盛证券研究所

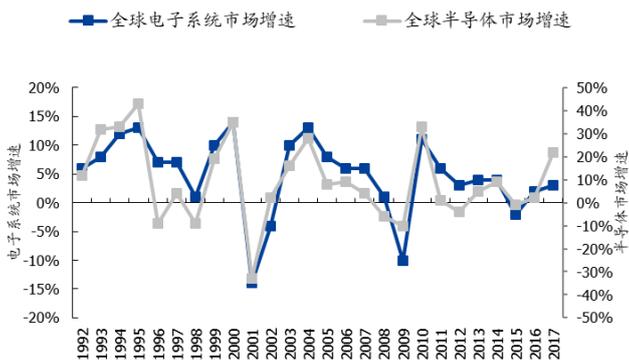
中国半导体市场增速在 17Q3 至 18Q1 曾短暂低于全球增速, 主要由于国内存储器产业仍处于突破初期, 而本轮半导体景气度主要推手为存储器产业, 所以导致国内产业增速短暂低于全球增速, 但长期来看我国半导体产业占全球比重提升的大趋势没有改变, 长期增速将始终维持较高水平。

图表 5: 全球及中国半导体销售额(单季度, 亿美元)



资料来源: 全球半导体贸易统计组织、国盛证券研究所

图表 6: 全球半导体市场增速



资料来源: 全球半导体贸易统计组织、国盛证券研究所

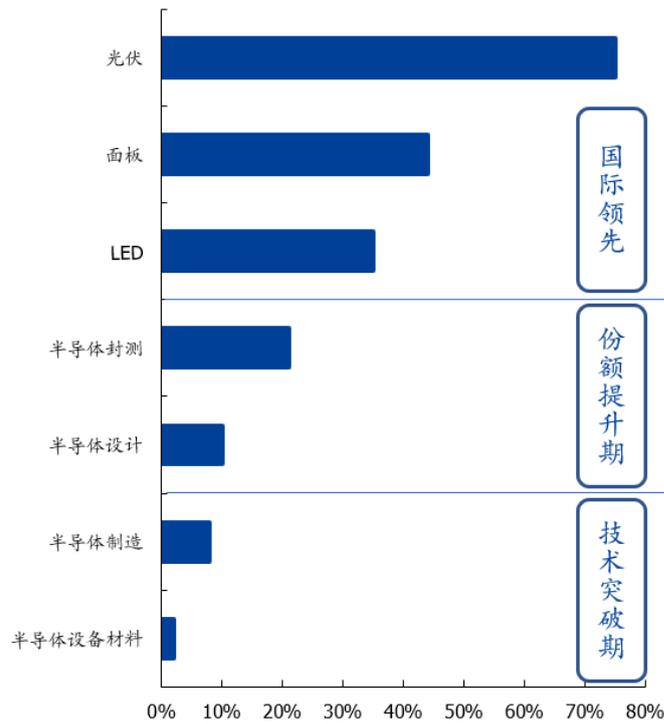
图表 7: 中国半导体市场增速



资料来源: 中国半导体行业协会、国盛证券研究所

产业第三次转移, 中国占比不断提高。从我国半导体产业迁移历史来看, 各细分板块均经历了技术突破、份额提升、国际领先三个阶段, 其中光伏、显示面板、LED 等泛半导体产业经过多年发展, 均已达到国际领先水平。目前半导体封装测试、IC 设计等产业已经站稳脚跟, 进入份额提升期。半导体制造、设备、材料等方面, 我国相关技术不断突破, 有望在区域聚集属性下, 重演产业迁移之路。

图表 8: 从我国产业市占率看产业迁移



资料来源: SEMI、IC Insight、WSTS、国盛证券研究所

1.3 哪些电子公司有望登上科创板的“首班车”？

科创板为电子领域企业尤其是集成电路带来了充分的机遇。科创板主要针对的企业来自五大行业领域，分别为：

- 第一类：新一代信息技术，包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等；
- 第二类：高端装备制造和新材料，主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床，机器人及新材料；
- 第三类：新能源及节能环保，主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保；
- 第四类：生物医药，主要包括生物医药和医疗器械；
- 第五类：技术服务领域，主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的公司。

自 2018 年 11 月 5 日以来，上海证监局披露接受上市辅导的有十余家，具有登录科创板潜力，其中半导体领域的企业占比较大。根据 2018 年 11 月 5 日以来证监会上海局网站的 IPO 辅导备案公告、科创板的上市条件（上市条件详情见图表 1）以及上海证券报的报道，我们筛选出了几家具有代表性的有望达成科创板“首班车”的半导体公司。

图表 9: 有望首批登陆科创板的公司

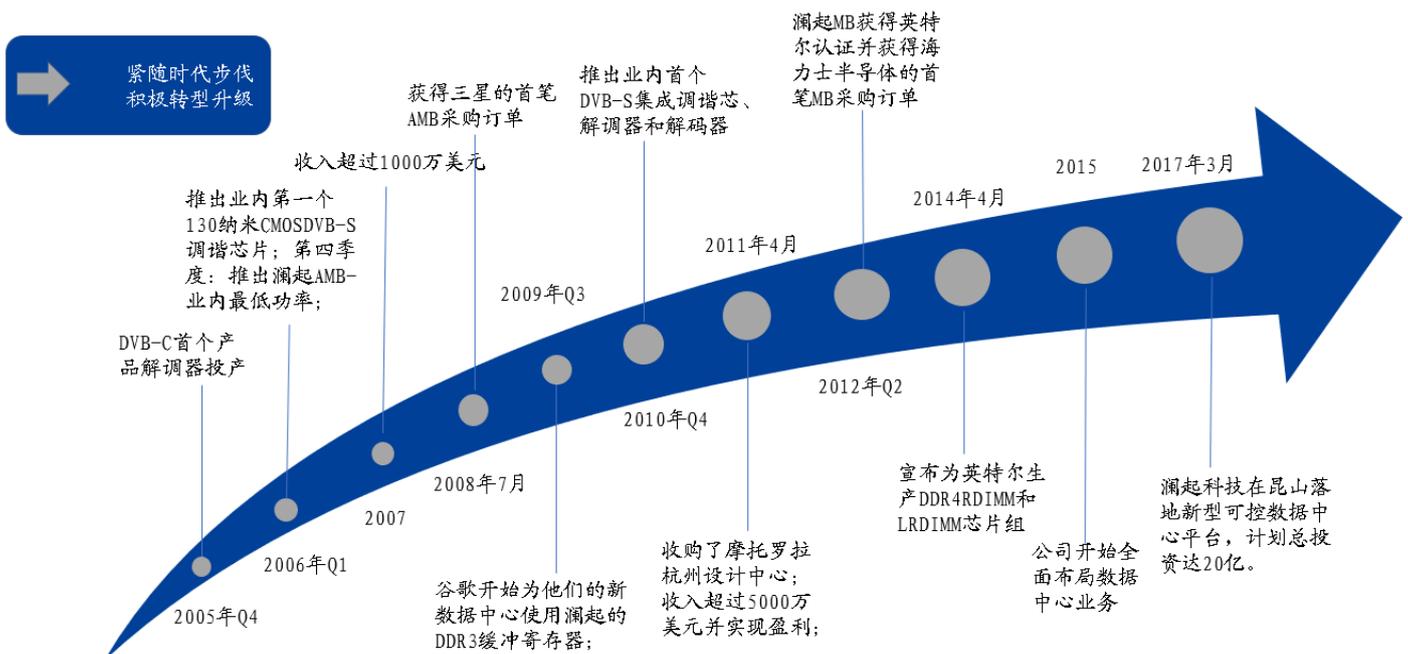
名称	所属领域	主要涉及产品
澜起科技	半导体	内存接口芯片
寒武纪科技	半导体	智能芯片
中微半导体	半导体	半导体设备
上海新晟半导体	半导体	半导体硅片
芯物科技	半导体	半导体技术、传感器技术、光电技术、物联网技术等领域的技术开发
苏州国芯	半导体	国产嵌入式 CPU
硅谷数模	半导体	接口芯片
安集微电子	半导体	半导体材料
晶晨半导体	半导体	芯片设计（影响影音处理芯片）
上海晶丰明源半导体	半导体	芯片设计（LED 照明驱动芯片）
聚辰半导体	半导体	芯片设计（EEPROM、智能卡、镜头驱动、运放）
上海微电子	半导体	集成电路设备（光刻设备、激光应用设备、光学检测设备和特殊应用设备）
乐鑫信息科技	半导体	芯片解决方案（无线通信芯片）
睿芯微电子	半导体	CMOS 图像传感器
东芯半导体	半导体	存储芯片（MEMORY）的研发及销售。
集创北方	半导体	显示控制芯片整体解决方案提供商

资料来源：国盛证券研究所根据证监会上海局网站的 IPO 辅导备案公告、科创板上市条件以及上海证券报整理

1、澜起科技

澜起科技成立于 2004 年 5 月，是业界领先的集成电路设计公司。其主营业务包括为数据中心和智能家庭娱乐市场提供以芯片为基础的解决方案。主营产品主要包括提供高性能且安全可控的 CPU、内存模组以及内存接口芯片解决方案。

图表 10: 澜起科技发展历程



资料来源：公司官网、国盛证券研究所

澜起科技目前量产最主要的产品为服务器市场内存接口解决方案，公司同时也是全球两家 DDR4 得到 Intel 认证的公司之一，也是全球首家可以量产 DDR4 寄存时钟驱动器芯片的公司。

图表 11: 澜起科技主要产品



内存接口解决方案公司先后推出了DDR2高级内存缓冲器（AMB）、DDR3寄存缓冲器（RB）及内存缓冲器（MB）、DDR4寄存时钟驱动器（RCD）及数据缓冲器（DB）等一系列内存缓冲芯片

混合安全内存模组采用澜起独有的内存监控技术Mont-ICMT（Inspection & Control on Memory Traffic），为数据中心高端服务器平台提供了可靠的数据安全性。

澜起津逮处理器是一款采用了预检测（PrC）和动态安全监控（DSC）技术的安全可控可信x86架构处理器，适用于津逮或其他通用服务器平台。

资料来源：公司官网、国盛证券研究所

2、中微半导体

中微半导体于2004年5月31日在浦东新区市场监管局登记成立，是一家微观加工设备研发商，为半导体行业及其他高科技领域服务。公司的主要设备和技术已达到全球领先水平，其主要产品包括芯片CCP刻蚀设备、芯片硅刻蚀设备、硅通孔刻蚀设备、MOCVD设备以及工业VOC净化设备等。

图表 12: 公司主要产品

公司产品	图片	市场大小	公司情况
芯片 CCP 刻蚀设备		>30 亿美元	国内市场占有率超过 40% 技术进入国际前列
芯片硅刻蚀设备		>30 亿美元	最新 ICP 设计 为 28nm 到 5nm 器件已进入芯片生产线验证
硅通孔刻蚀设备		>5 亿美元	国内市场占有率超过 50% 技术进入国际前列
MOCVD 设备		>5 亿美元	已进入国内多家领先的厂商 技术进入国际前列
工业 VOC 净化设备			LCD 产业优先推广、已实现销售

资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

作为我国半导体设备领军企业, 中微半导体自主研发的 5 纳米等离子体刻蚀机近期经台积电验证, 性能优良, 也将用于全球首条 5 纳米制程生产线。中微目前申请专利数量过千, 根据国家知识产权局官网数据库显示, 不包括还未公开的相关专利, 仅目前在大陆获得授权的有效专利数量就已达 473 项, 且公司已在全球建立了完善的知识产权管理制度。

3、芯原半导体

芯原成立于 2001 年, 总部位于中国上海, 在中国和美国设有 5 个设计研发中心, 全球共有 10 个销售和客户服务办事处, 目前员工已超过 700 人。芯原是一家芯片设计平台即服务(Silicon Platform as a Service)公司, 提供世界一流的系统级芯片(SoC)和系统级封装(SiP)一站式解决方案; 同时也是一家领先的 IP 供应商, 拥有业界最全面的 IP 组合。芯原业务范围涵盖移动互联设备、数据中心、物联网(IoT)、汽车、工业和医疗设备等领域。

图表 13: 芯原半导体的业务模式



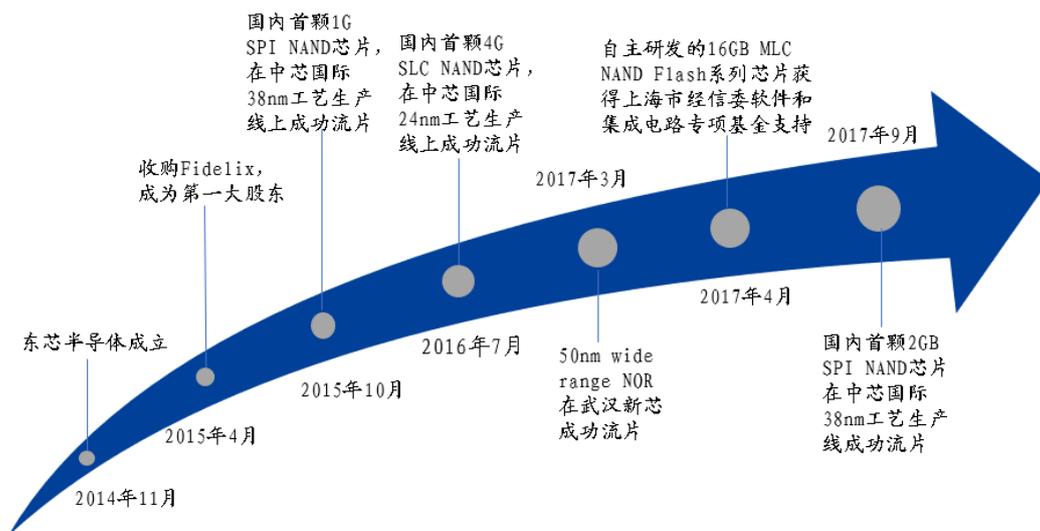
资料来源：公司公告、国盛证券研究所

芯原一站式服务为包含新兴和成熟半导体厂商、原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)，以及大型互联网和云平台提供商在内的各种客户提供高效经济的半导体产品替代解决方案。

4、东芯半导体

东芯半导体成立于2014年11月26日，是由东方恒信资本控股集团有限公司通过下属企业上海闻起投资有限公司为主发起设立的中国半导体设计公司，主要从事存储芯片(MEMORY)的研发及销售。

图表 14: 东芯半导体发展历程



资料来源：公司公告、国盛证券研究所

东芯是一家 Fabless 芯片企业，聚焦中小容量 NAND、NOR 闪存芯片、DRAM 内存以及 MCP 的设计、生产和销售，有望成为国内可以同时提供 NAND/NOR/DRAM/MCP 设计工艺和产品方案的本土存储芯片研发设计公司。

图表 15: 公司主要产品

产品	事例图片	备注
SPI NOR		可提供通用 SPI 接口不同规格的存储器
PPI NAND		自主设计，密度大，寿命长
SPI NAND		单芯片方案，同时带有内部 ECC，节约空间，性价比高
DDR3		标准 SSTL 接口
LPDDR		LPDDR1 以及 LPDDR2 系列产品
MCP		Flash 和 DDR 合并封装

资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

5、集创北方

北京集创北方科技股份有限公司作为全球领先的显示控制芯片整体解决方案提供商，围绕移动显示、面板显示、LED 显示三大领域，形成了多元化的产品布局，主要产品线包括全尺寸面板驱动 (LCD/AMOLED Driver)、触控 (Touch)、指纹识别芯片、电源管理芯片 (Power IC)、信号转换 (Convertor)、时序控制 (Timing Controller; TCON) 及 LED 显示驱动等，能够为客户提供 TV、Monitor、Notebook、Tablet、Smart Phone 以及可穿戴设备等不同产品屏幕的显示解决方案，同时拥有多种技术整合能力。

图表 16: 集创北方主要产品



资料来源: 公司官网、国盛证券研究所

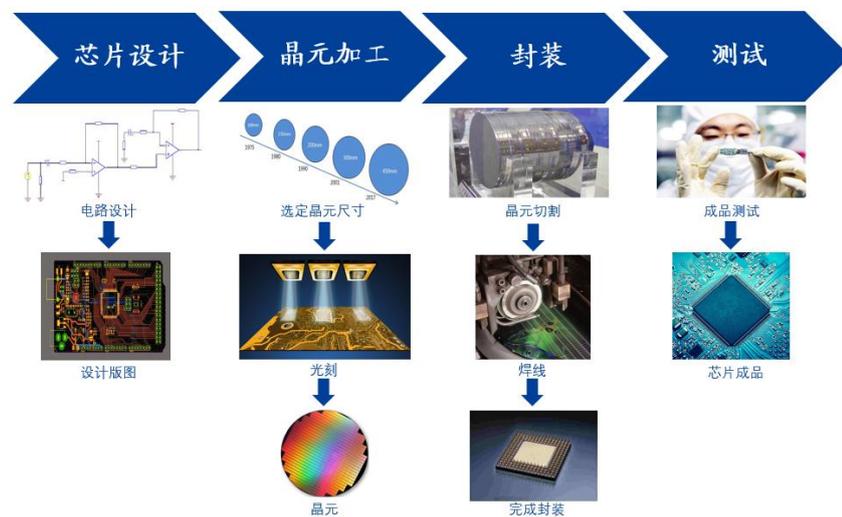
6、华润微电子

华润微电子有限公司是华润集团 100%控股的负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业，亦是中国本土具有重要影响力的综合性微电子企业，自 2004 年起连续被国家工业和信息化部评为中国电子信息百强企业。

公司业务包括集成电路设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试及分立器件，业务范围遍布无锡、深圳、上海、重庆、香港、台湾等地。目前拥有 6-8 英寸晶圆生产线 5 条、封装生产线 2 条、掩模生产线 1 条、设计公司 3 家，为国内拥有完整半导体产业链的企业，并在特色制造工艺技术居国内领导地位。

华润微电子拥有完整的产业链结构：包括 IC 设计、掩模制造、晶圆制造、晶圆测试、封装与成品测试。

图表 17: 华润微电子核心产业链



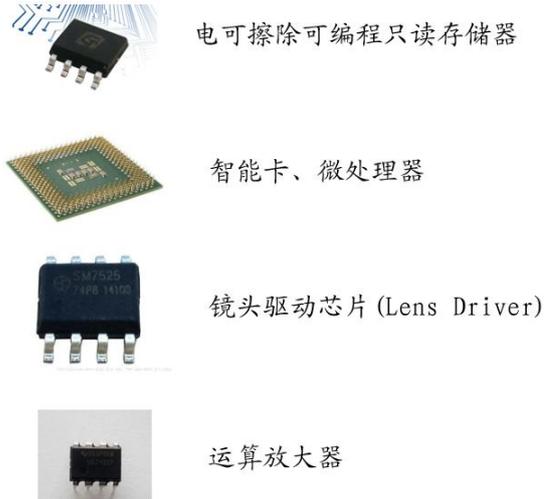
资料来源：国盛证券研究所整理

7、聚辰半导体

聚辰半导体专门从事研发，制造和销售高性能、高品质模拟和数字集成电路产品的高科技公司。公司不仅为客户提供所需要的元器件，同时也为客户提供应用的完整的解决方案。

聚辰半导体目前拥有 EEPROM、智能卡/MCU、镜头驱动芯片(Lens Driver)和运算放大器四条产品线。产品已广泛应用于消费电子、汽车电子、通讯、电脑及周边、工业控制、智能识别、公共交通等诸多领域。

图表 18: 聚辰半导体主要产品



资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

聚辰是全球排名第四的 EEPROM 供应商, 是手机摄像头领域组合产品 (EEPROM + Lens Driver) 的全球最大的供应商。聚辰同时也是国内主流智能卡芯片供应商, 拥有国家商用密码产品生产/销售证书, 是住建部城市一卡通专有芯片供应商。

聚辰主要终端客户包括华为、海尔、海信、中兴、OPPO、vivo、小米、联想、伟易达、三星、LG、友达、群创、富士康、京东方、华星光电、佳能、富士施乐等国内外知名厂商。

聚辰半导体截止 2018 年底研发人员占比超过 52%, 公司不断加大研发投入, 除了完善非易失性存储器产品系列, 还将推出 DDR5 SPD 产品、汽车级 EEPROM, 以及新型音频功放等新产品。

8、晶晨半导体

晶晨半导体成立于 1995 年, 是全球无晶圆半导体系统设计的领导者, 为多种开放平台提供各种多媒体电子产品, 包括 OTT、IP 机顶盒、智能电视和智能家居产品。

图表 19: 公司主要产品

公司产品	备注
智能机顶盒	新一代智能机顶盒将是一种整合传统广播内容、高品质 OTT 内容递送、游戏主机、本地媒体播放及互联网应用的多功能设备
智能电视	将交互式互联网应用和内容点播功能与传统的广播相整合, 用户更可以执行安装和卸载各类应用软件, 持续对功能进行扩充和升级
智能家居	人们可以使用遥控器或者远程 APP, 通过智能家庭主机对各种末端设备, 包括灯光, 窗帘, 空调及安防监控等的控制, 实现最佳的居住环境体验。
智能电视棒	智能电视棒外形如普通的 U 盘, 通过 HDMI 或者 MHL 接口输出高清画面到大屏设备, 和 OTT 机顶盒一样可以通过 WiFi 支持高品质 OTT 内容递送、游戏主机、本地媒体播放及互联网应用的多功能设备。
智能投影仪	智能投影仪集多媒体播放, 网络互联, 人机交互, 远程会议等应用一体, 无需显示屏和外接媒体源

资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

晶晨半导体拥有高清多媒体处理引擎、系统 IP 和业界领先的 CPU 和 GPU 技术, 为付费

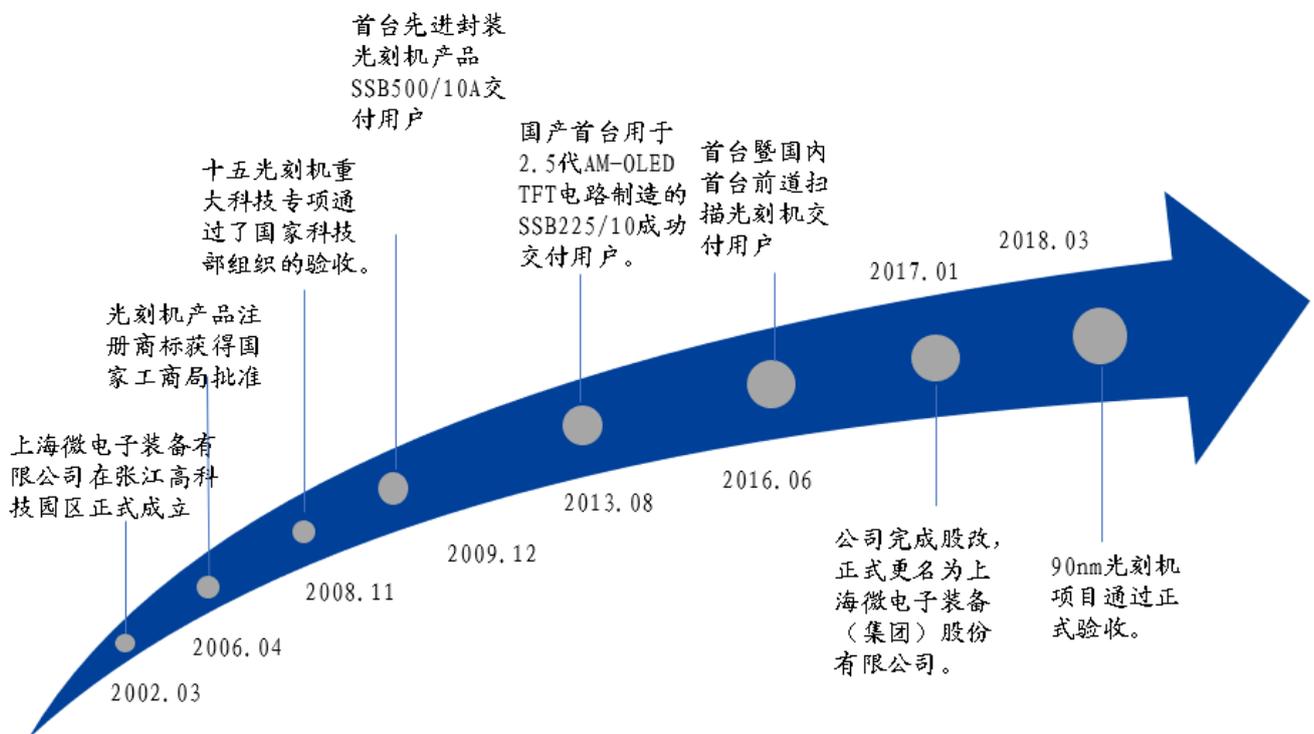
电视运营商、OEM 和 ODM 厂商提供产品解决方案；能够提供 Android 和 Linux 的交钥匙方案，帮助合作伙伴快速部署市场。

近年来，晶晨半导体发展迅猛，以其成本、性能等优势在市场上得到创维、索尼、TCL、小米、阿里巴巴等众多知名厂商青睐。晶晨半导体近年在 OTT 盒子和电视市场取得不错的增长，支撑了公司业绩的持续上升。

9、上海微电子

上海微电子装备(集团)股份有限公司(简称 SMEE)主要致力于半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务。公司产品广泛应用于集成电路前道、先进封装、FPD 面板、MEMS、LED、Power Devices 等制造领域。

图表 20: 上海微电子发展历程



资料来源: 公司公告、国盛证券研究所

图表 21: 公司主要产品

主要产品	描述
600 扫描光刻机系列—前道 IC 制造	基于先进的扫描光刻机平台技术, 提供覆盖前道 IC 制造 90nm 节点以上大规模生产所需, 包含 90nm、130nm 和 280nm 等不同分辨率节点要求的 ArF、KrF 及 i-line 步进扫描投影光刻机。
500 步进光刻机系列—后道 IC、MEMS 制造	基于先进的步进光刻机平台技术, 提供覆盖后道 IC 封装、MEMS/NEMS 制造的步进投影光刻机。
200 光刻机系列—AM-OLED 显示屏制造	200 系列投影光刻机综合采用先进的步进光刻机平台技术和扫描光刻机平台技术, 专用于新一代 AM-OLED 显示屏的 TFT 电路制造。
硅片边缘曝光机系列—芯片级封装工艺应用	SMEE 开发的硅片边缘曝光机提供了满足芯片级封装工艺中对硅片边缘进行去胶处理的能力, 设备可按照客户要求配置边缘曝光宽度、硅片物料接口形式、曝光工位等不同形式。设备同时兼容 150mm、200mm 和 300mm 等三种不同规格的硅片。
精密温控系列—光刻机、刻蚀机应用	SMEE 为集成电路行业提供多种超/高精度温度控制装置, 可分别用于半导体前道设备中的扫描光刻机和各种用途的刻蚀机等设备的精密温度控制, 也可应用于精密光学、仪器、精密机床制造及各种科学实验场所。
精密温度控制解决方案	SMEE 提供各种类型的超高精度温度控制全面解决方案, 可按客户具体需求提供从设计、制造、安装、调试到维护的一条龙服务, 可应用于光学镜头、光栅、精密元件、精密仪器和精密机床制造等领域, 尤其适合于材料提纯、测试、测量和定位定准等各种科学实验场合。

资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所

二、投资组合推荐

推荐重点配置半导体、5G、有业绩保障的消费电子。

半导体:

存储: 兆易创新;

模拟: 韦尔股份、圣邦股份、富满电子;

数字芯片 GPU: 景嘉微; AP: 北京君正、全志科技;

IDM: 闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电子;

化合物半导体: 三安光电;

设备: 北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技;

材料: 兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子;

封测: 长电科技、华天科技、通富微电;

安防:

海康威视、大华股份、千方科技;

消费电子:

立讯精密、欧菲科技、领益制造、东山精密、环旭电子、蓝思科技、信维通信;

PCB:

深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎科技、生益科技;

5G 相关:

深南电路、沪电股份、硕贝德、麦捷科技;

面板以及相关: 京东方、劲拓股份、濮阳惠成;

元器件: 火炬电子、顺络电子、三环集团、法拉电子;

三、电子本周行业动态

1. 华为发布首款 5G 折叠屏手机

集微网消息，华为在 MWC2019 上发布了 Mate X，官方介绍该机的折叠屏采用了鹰翼式折叠设计，中间为铰链结构，当中含有的零件就超过了 100 个。最厉害的是当屏幕折叠后手机中间是零缝隙，也是现时第一款零缝隙的折叠屏手机。折叠后整机厚度为 11mm 展开后厚度也仅为 5.4mm，也是现时最纤薄的折叠屏手机。

集微网

图表 22: 华为首款折叠屏手机



资料来源：华为，国盛证券研究所

2. 工信部发超高清视频内容产业行动计划：大力发展 4K，同时兼顾 8K

工信部发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，指出 2020 年国内 4K 产业生态体系基本完善，8K 关键技术产品研发和产业化取得突破，而 2022 年 4K 电视终端全面普及，8K 电视占比要达到 5%。

在这份计划中提到了国内的超高清视频产业规划了方向及要求，按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

集微网

3. 加拿大司法部就孟晚舟引渡案签发授权进行令

当地时间 3 月 1 日，加拿大司法部宣布，授权加拿大法庭就美方引渡中国华为公司首席财务官孟晚舟女士的要求进行司法审理。

按照加美之间的引渡协议，美方司法部门在提出引渡要求后，需要加方司法部门签发授权进行令，法庭随后启动听证和裁决。这个授权进行令是程序性的。由于美方的引渡要求是 1 月 29 日正式提出的，按照相关程序，加方要在 30 天之内决定是否签发授权进行令。加方是在这一期限的最后一天签署了授权进行令。

按照此前的安排，设在温哥华的不列颠哥伦比亚省高等法院的一个法庭 3 月 6 日对引渡孟晚舟女士的要求进行听证。也就是说，在授权进行令签发之前，就已经确定法庭听证。

集微网

4. 114.35 亿元的合肥广芯完成交割，闻泰收购安世半导体取得阶段性成功

3 月 1 日晚间，闻泰科技发布公告，截至目前，本次交易已完成标的资产的过户手续及相关工商登记，合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额已过户至合肥中闻金泰名下。闻泰科技也已取得对合肥中闻金泰的控股权。

集微网

5. pmd 携手徕卡 全球最小 ToF 模组嵌入顶级光学镜头

据麦姆斯咨询报道，德国著名的 Leica Camera（徕卡相机股份公司）和全球领先的高性能飞行时间（ToF）深度传感解决方案无晶圆厂 IC 供应商 pmdtechnologies，近日宣布双方战略联盟的下一个里程碑，将联合为移动设备开发并市场化 3D 传感摄像头解决方案。双方合作打造了一款专为移动应用开发的新参考设计“Holkin”。

摩尔芯闻

6. iQOO 手机正式发布：骁龙 855 游戏怪兽，44W 超快闪充

vivo 旗下子品牌 iQOO 手机今天正式发布，搭载骁龙 855 处理器，6.41 英寸水滴屏，4000mAh 电池，售价 2998 元起，今日开启预售，3 月 6 日全网首销。

摩尔芯闻

7. 中国移动在西藏开通首个 5G 基站

据中国西藏网报道，中国移动西藏公司于 2 月 27 日在拉萨开通西藏首个 2.6GHz 频段 5G 基站，此举意味着西藏正式进入 5G 时代。在户外环境下，经测试西藏移动的 5G 网络下载峰值速率达 530M/秒，平均速率在 500M 左右。

根据中国移动拉萨分公司网络部经理尼玛顿珠的说法，中国移动西藏公司已在拉萨市完成 3 个 5G 基站的建设工作。据介绍，下一步，西藏移动将加紧西藏 5G 应用方面的测试工作，助推西藏通过 5G 网络发展推动大数据产业、智慧旅游、智慧城市、智慧公安等物联网产业的创新应用。

摩尔芯闻

8. 鸿海在美国开始征求研发人才

鸿海集团在美国求职网站上继续征求知识型研发人才，本周又新添了 15 个工程师相关职缺，合计征求的职位已经超过了 80 个。

鸿海集团更新的职缺以威斯康辛州为主，包含系统软件工程师、软件自动化测试、软件质量保证工程师、电子元件工程师等职缺。鸿海表示，看好美国当地研发人才，探索推动工业互联网技术的可能，创造诸如教育、医疗保健、娱乐、运动、安全和智慧城市等高科技应用的解决方案。

新浪科技

9. OPPO 将进军欧洲四国市场

据路透社报道，OPPO 在巴塞罗那表示，今年将会继续进军欧洲市场，德国、罗马尼亚、保加利亚和乌克兰将可能成为下一个目标。据研究机构 Gartner 的数据显示，2018 年第四季度，OPPO 智能手机销量全球排名第四，达到 3160 万台，约占 7.7% 的市场份额。OPPO 全球副总裁兼海外业务副总裁 Alen Wu 表示，从 2018 年以来，OPPO 已经进入了 10 个新的市场，包括西班牙和英国。

全球半导体观察

10. 紫光展锐发布首款 5G 基带芯片，发力 5G 技术

近日举办的 MWC 大会上，紫光展锐正式发布了首款自主研发的 5G 通信技术平台：马卡鲁与其首款基带芯片——春藤 510，而这款芯片受到业内人士广大好评。

据介绍，春藤 510 采用台积电 12nm 制程工艺，符合最新的 3GPP R15 标准规范，可支持 2G/3G/4G/5G 多种通讯模式；支持 Sub-6GHz 频段及 100MHz 带宽；也可同时支持 SA（独立组网）和 NSA（非独立组网）两种方式，是一款高集成、高性能、低功耗的 5G 基带芯片。

摩尔芯闻

11. 十倍光学变焦引领手机拍照进入新时代

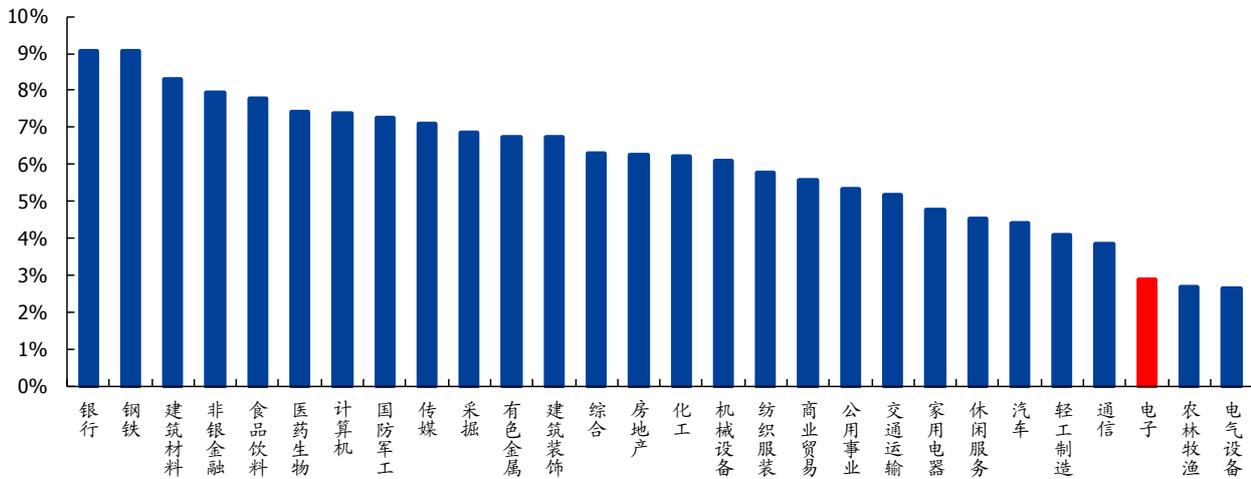
OPPO 发布了十倍光学变焦技术。按过去的技术，将“十倍变焦镜头”装进手机，厚度至少要 15mm。OPPO 创造性地解决了这个难题，他们使用了潜望式结构，将镜头转向、折叠，把“厚度”转变为“宽度”，把望远镜变成潜望镜，在实现成像的同时，整个摄像头模组也控制在 6.76mm 以内。OPPO 准备了一套“超广角+超清主摄+长焦”的三摄解决方案，其中包括一颗拥有 120° 视角、16mm 等效焦距的超广角摄像头；一颗 4800 万像素的超清主摄；以及一颗具备 160mm 等效焦距的长焦摄像头。其中主摄和长焦镜头都具备光学防抖机能，长焦镜头采用基于棱镜让光学通道转 90 度弯的潜望镜式设计，配合另外两颗镜头能以“接棒”的方式实现 10 倍光学变焦的效果。

摩尔芯闻

四、本周行情回顾

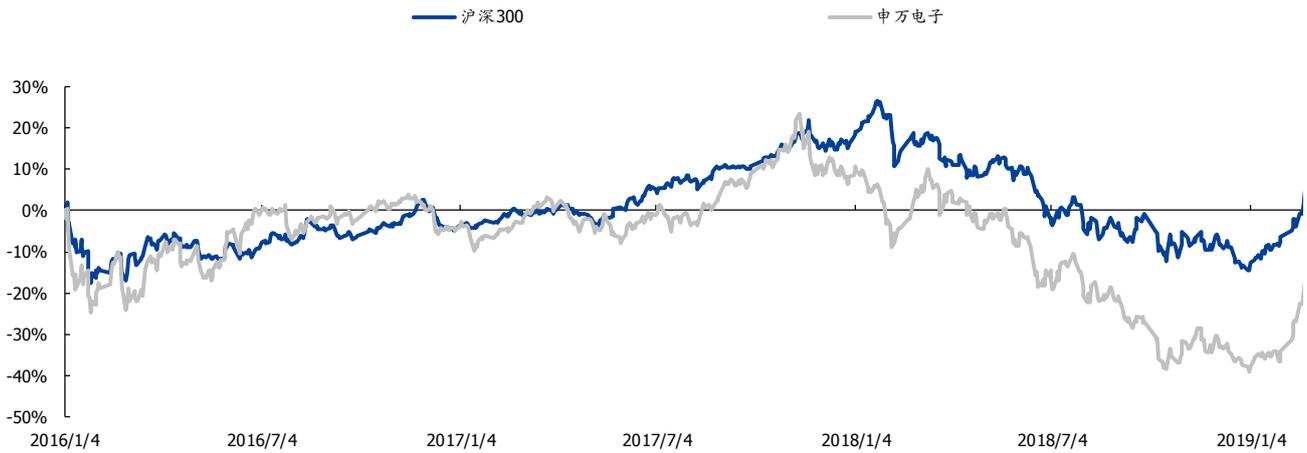
本周沪深 300 上涨 6.52%，申万电子指数上涨 2.86%，跑输沪深 300 指数 3.66 个百分点，在 28 个申万一级行业中涨幅排名第 26。

图表 23: 申万一级行业周涨跌幅



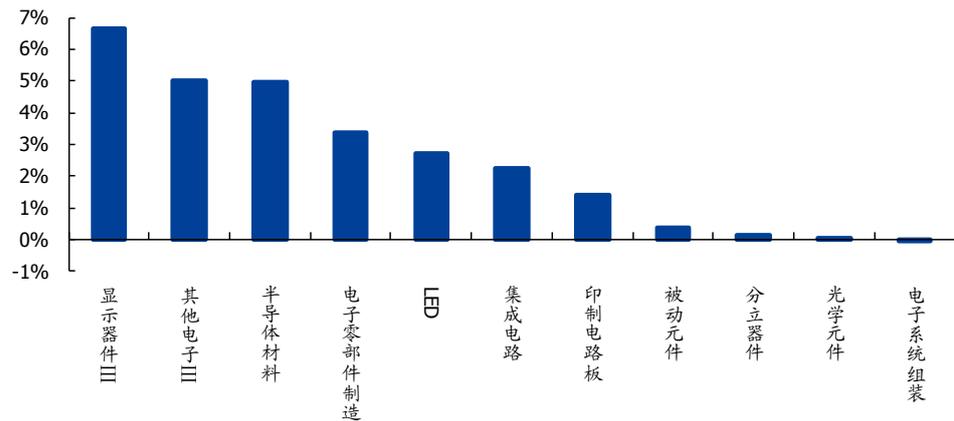
资料来源: Wind、国盛证券研究所

图表 24: 电子行业指数相对沪深 300 表现



资料来源: Wind、国盛证券研究所

图表 25: 细分行业周涨跌幅



资料来源: Wind、国盛证券研究所

风险提示

下游需求增长不及预期、宏观环境边际恶化。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
减持		相对同期基准指数跌幅在10%以上	

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区锦什坊街35号南楼

邮编：100033

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路868号保利One56 10层

邮编：200120

电话：021-38934111

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com